

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 04-354144

(43)Date of publication of application : 08.12.1992

(51)Int.Cl.

H01L 21/66

G01R 31/26

(21)Application number : 03-155580

(71)Applicant : VACUUM METALLURGICAL CO
LTD

(22)Date of filing : 30.05.1991

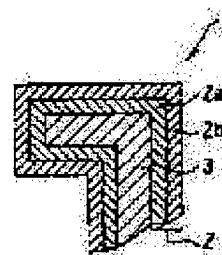
(72)Inventor : OBA AKIRA
OISHI SEIJI
IKUYAMA YOSHIFUMI
KAKIYAMA KATSUKI
MAENOZONO MASANORI

(54) ELECTRODE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an electrode having high elasticity and high resistance to wear at a low cost wherein foreign matter adhesion is remarkably reduced.

CONSTITUTION: A lamination coating film 2 composed of an adhesion layer 2a and a rigid layer 2b is formed on contact 1 of an IC tester whose base material is stainless. The adhesion layer 2a as the base coating film of the lamination coating film 2 is formed by an ion plating method of titanium. The rigid layer 2b as the upper coating film is formed of titanium nitride by the same method. The contact 1 wherein the stainless base material is covered with the lamination coating film 2 is excellent in elasticity, wear resistance and conductivity.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than
the examiner's decision of rejection or
application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平4-354144

(43) 公開日 平成4年(1992)12月8日

(51) Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/06	E	7013-4M		
G 0 1 R 31/26	G	8411-2C		
H 0 1 L 21/06	D	7013-4M		

審査請求 未請求 請求項の数3 (全 6 頁)

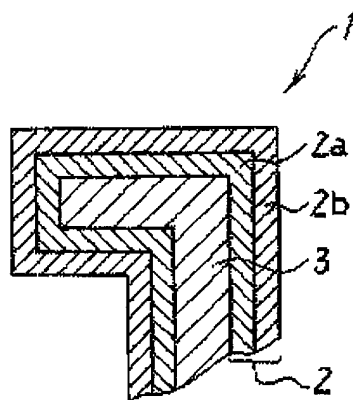
(21) 出願番号	特願平3-155550	(71) 出願人	000192372 真空冶金株式会社 千葉県山武郡山武町横田516番地
(22) 出願日	平成3年(1991)5月30日	(72) 発明者	大場 彰 千葉県成田市玉造2丁目15番4号
		(72) 発明者	大石 政治 千葉県習志野市秋津2-2-9-402
		(72) 発明者	生山 芳文 熊本県熊本市健甕町2834-37
		(72) 発明者	楠山 桂治樹 熊本県熊本市東町4-74
		(72) 発明者	前之圓 正則 鹿児島県姶良郡横川町中ノ1380
		(74) 代理人	弁理士 飯阪 泰雄

(54) 【発明の名称】 電 極

(57) 【要約】

【目的】 高導性で耐摩耗性があり、異物の付着が大巾に減少されて、しかも安価となる電極を提供すること。

【構成】 ステンレスを基材としたICテスターのコンタクト1に密着層2aと硬質層2bとからなる、積層被膜2を形成させる。積層被膜2の下地被膜としての密着層2aはチタンをイオンプレーティング法により形成させ、上地被膜としての硬質層2bは窒化チタンを同方法により形成させる。ステンレス基材に積層被膜2が覆われたコンタクト1は弾性、耐摩耗性に優れ、かつ導電性のよいものである。



2.....積層被膜
2a.....密着層
2b.....硬質層
3.....基 材

(2)

特開平4-354144

1

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材に特殊被膜を施した電極において、前記基材を比較的硬い導電材で構成し、前記特殊被膜を比較的硬い導電性の金属化合物を主成分とする上地被膜と、前記金属化合物の成分である金属の下地被膜とからなる積層被膜とすることを特徴とする電極。

【請求項2】 前記基材が銅合金、鉄合金、ニッケル合金、アルミニウム合金、タングステン、モリブデン、チタンのうちいずれか1つである請求項1に記載の電極。

【請求項3】 前記金属がチタン、タンタル、ニッケル、ニオブ、バナジウム、ハフニウムのうちいずれか1つであり、前記金属化合物が前記金属の窒化物、炭化物又は硼化物である請求項1又は2に記載の電極。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、IC/LSIテスターの先端につけられたハンドラーやICソケット等の高弾性と高信頼性を要求される電極に関する。

【0002】

【従来の技術及びその問題点】 従来の電極は銅合金基材の表面に、酸化防止のために金、白金及びロジウム等の貴金属のメッキ被膜を施したものが知られている。従って、①基材は引張強さ及び弾性が低く、繰り返し使用しているうちに、ばね特性が弱り、へたりとか折れが生じていた。②被検査物の半田とか、銀とかが電極に付着して酸化し、絶縁性のごみとなり、接触不良となっていた。③又、電極の先端についたごみを取ろうとすると、酸化防止のための貴金属メッキ被膜まで落ちてしまうなどの問題があり、長期の使用に耐えなかった。

【0003】

【発明が解決しようとする問題点】 本発明は、以上のような問題に鑑みてなされ、弾性及び耐摩耗性に優れた長寿命電極を提供することを目的としている。

【0004】

【問題点を解決するための手段】 上記の目的は、基材に特殊被膜を施した電極において、前記基材を比較的硬い導電材で構成し、前記特殊被膜を比較的硬い導電性の金属化合物を主成分とする上地被膜と、前記金属化合物の成分である金属の下地被膜とからなる積層被膜とすることを特徴とする電極によって達成される。

【0005】

【作用】 電極の基材に密着層と硬質層とからなる積層被膜を形成しているため、密着層が基材と硬質層の密着強度を高め、硬質層が基材から剥離しなくなる。また、基材より硬い積層被膜を基材に形成することにより、引張強さ及び弾性限度が高くなり、ばね特性が改善される。

【0006】

【実施例】 次に実施例について図面を参照して説明する。図1に本発明の実施例にかかるICテスター4のコンタクト1の斜視図を示し、図2にそのICテスター4

のコンタクト1の先端部の拡大断面を示している。

【0007】 コンタクト1は図2に示すように、導電性がある金属のステンレスを基材3として、積層被膜2を形成したものであり、基材3の表面に下地被膜としてチタン(Ti)からなる密着層2aを形成し、その上の上地被膜に、主として窒化チタン(TiN)からなる硬質層2bを形成したものである。チタン及び窒化チタンはいずれも導電性があり、かつ硬いものであり、更にコンタクト1の酸化を防止することができる。

【0008】 基材3の表面上への積層被膜2の形成は以下のようなイオンプレーティング法によって行なった。図3に示すような、排気弁6を介して真空排気系(図示せず)に接続される真空槽5の中に設けられた支持板10に基材3を取りつけた。基材3と対向する位置に蒸発物質としてチタン(Ti)の入った水冷銅製ハース7と中空陰極型電子銃8とを設けた。又、他のノズル9からは反応性ガスとして窒素ガスが供給される。

【0009】 まず、真空槽5の内部を真空引きし 5×10^{-6} Torrとした。次いで中空陰極型電子銃8にアルゴンガスを流しながら(5×10^{-4} Torrになる)水冷銅製ハース7と電子銃8との間に直流電源RFスターター(DC・RF)により電圧をかけ、中空陰極放電を起こしてチタンを蒸発させ、支持板10にバイアス電圧-50Vをかけると、基材3の表面にチタン被膜が形成された。次いでノズル9から窒素ガスを導入し、内部の真空度が 2×10^{-6} Torrになるように調整すると、基材3上には更に窒化チタン(TiN)被膜が形成された。X線回折によって調べたところ、この被膜は主として窒化チタン(TiN)からなり、その他にチタン(Ti)も含まれていた。以上の方法によって得られた密着層2aのチタン被膜の厚さはコンマ数 μm 、窒化チタンを主とする硬質層2bの膜厚は約 $2 \mu\text{m}$ であった。上記工程中の成膜速度は0.1~0.3 $\mu\text{m}/\text{min}$ であった。又、得られたコンタクト1の硬質層2bの上からマイクロビッカース硬度計で硬度を測定したところ、約Hv 1400であった。

【0010】 以上のように密着層2aを設けることによって被膜の同着力が増加する。密着層2aを設けずに直接硬質層2bを形成すると同着力が弱く、使用しているうちに剥離してしまう。密着層の厚さは $1 \mu\text{m}$ 以下でも充分であった。

【0011】 次に、高度の高い積層被膜を形成した基材と形成しない基材とについて弾性を比較するため、図3に示す真空槽5を用い、コンタクト1の形状の基材3に密着して、同じくステンレスを基材とするが、その厚さが0.2mmである試料を支持板10に吊り下げて、上述したコンタクト1の基材3に積層被膜2を形成させたのと同様の方法により(なお、形成する積層被膜の厚さも、作業内容も同じであるのでその説明を省略する。)、ステンレス基材にチタンの密着層と窒化チタン

(3)

特開平4-354144

3

の硬質層からなる積層被膜を形成させた。これを巾×長さ
が10mm×70mmとなるように切りだし、実験用
試料15を作製した。

【0012】実験用試料15は図4に示すように、この
試料15の一端（長さ20mm）を固定支持し、他端、
すなわち自由端に力を加えて、弾性限度（応力とともに
生じた歪みが応力を取り去った後に消滅して、材料が完全
に弾性を保つ最大限の応力をいうが、応力とともに生
じた歪みが応力を取り去った後に消滅して、材料が完全
に弾性を保つ最大限の歪みの長さを測定する。）を示す
30 歪み量Fを測定したところ、歪みが20mmであった。
これに対して、積層被膜の形成されていない基材は6mm
であり、積層被膜を形成させたことにより弾性限度が
3倍以上となり、ばね特性が大巾に改善されることがわ
かる。

【0013】又、本実施例のステンレス基材に積層被膜
を形成したもののヤング率を測定すると287×10N
/mmと従来使用しているベリリウム銅の約2.26倍
（積層被膜を形成しないステンレス鋼SUS304とベ
リリウム銅では約1.5倍、機械工学便覧、材料編によ
ればステンレス鋼SUS304は197GPa、ベリ
リウム銅は130GPa）であった。

【0014】従来のコンタクトと本実施例のコンタクト
とを各々IC12スターに組み込んで以下の比較実験を行
なった。従来のコンタクトは、ベリリウム銅製の表面に
金（Au）メッキしたものである。

【0015】図5に示すようにIC12のICリード1
3に、円筒体11を介させて一定荷重Pを加え、コン
タクト1の先端部を押すつ、ICリード13に電流を
流すテストを100サイクルづつ行なった。実験後の従
来コンタクト及び本実施例のコンタクトの接触した面を
それぞれ図6のA及び図6のBに示す。従来コンタクト
は図6のAに示すように表面に半田の付着が生じ、その
付着部の一帯に黒色部が見られた。又、付着部以外に
も、黒色部が見られた。これらの黒色部は、金被膜が接
触するICリード13によってコンタクトから剥離し、
ベリリウム銅が酸化して生じたものと考えられる。更に
外部からのごみ及び半田の付着とも考えられる。

【0016】一方本実施例によって得られたコンタクト
は図6のBに示すように変色がなく、初期状態と全く同
等であった。

【0017】なお、従来のコンタクトでは、5000サ
イクルの実験をした時点で接触部に不具合の生じたもの
が3%あった。（良品が不良と判定された）本実施例の
コンタクトでは不具合は発生しなかった。

【0018】次に両コンタクトで電気特性に差があるか
どうかを調べるために次の実験を行なった。

【0019】初期状態の従来コンタクトと本実施例コン
タクトのそれぞれに一定の電圧をかけ、負荷抵抗を変え
て0.092～0.75mAの電流を流し、相関係数を

4

求めたところ、0.999という値が得られ、両コンタ
クトでは電気特性上の差は認められなかった。

【0020】図7に0.38～0.75mAのプロット
した実例を示す。

【0021】なお、本実施例のコンタクトはステンレス
ばねの基材の頭部表面のみにチタン及び窒化チタンの積
層被膜2が形成された構造であるので、コンタクトの下
部の被膜を設けていない部分を半田付けすることができ
る（窒化チタンには半田付けができない）。

【0022】本発明のコンタクトを引き続き15000
サイクルの連続試験を行なったところ、ほんの少しの変
色が始められた。これを紙やすりでこすると、変色部の
みきれいに落ち、新品同様となった。

【0023】窒化チタン膜の上に半田が付着した後酸化
したのが変色部であり、紙やすりでこすることにより窒
化チタン膜上の半田はきれいに落ち、窒化チタン膜は紙
やすりより硬いので、落ちないためコンタクトの表面は
新品同様となる。

【0024】引き続き50000サイクルの連続試験を
行なった。従来コンタクトは2～3本折れが発生した
が、本発明品は、異常が全く発生しておらず、本発明は
従来品より非常に優れた特性を示した。

【0025】本発明の金属化合物として適切なものは比
較的硬く、かつ導電性の高いものである。図8は各種化
合物の硬さと融点の関係を示す図であり、図9は各種化
合物の電気比抵抗を示す図であるが、硬度がヌーブ硬度
（H_n）で約1200以上、かつ電気比抵抗が約10⁻⁴
Ω・cm以下であればよく、具体的にはチタン（Ti）、
ハフニウム（Hf）、タンタル（Ta）、ニッケル（Ni）、
ニオブ（Nb）、バナジウム（V）の窒化
物、炭化物又は硼化物が使用できる。これらはいずれも
酸化しにくいものであり、基材の酸化を防ぐためにも有
効である。

【0026】前記実施例のチタン及び窒素ガスを要した
以外は全く同一の条件で、次のような実験を行なった。
基材にステンレスばねを用いた点も同様である。

【0027】（1）金属としてチタン（Ti）を用い、
窒素ガスの代わりにメタンガスを導入して、チタンから
なる密着層と、炭化チタン（TiC）を主とする硬質層
を形成した。

【0028】（2）金属としてチタンの代わりにハフニ
ウム（Hf）を用い、窒素ガスを導入してハフニウムか
らなる密着層と、窒化ハフニウム（HfN）を主とする
硬質層を形成した。

【0029】（3）金属としてチタンの代わりにニッケ
ル（Ni）を用い、窒素ガスを導入してニッケルからな
る密着層と、窒化ニッケル（Ni₃N₂）を主とする硬
質層を形成した。

【0030】（4）金属としてチタン（Ti）を用い、
ステンレスばねにチタン（Ti）膜を3～5μm形成

(4)

特開平4-354144

5

し、イオン注入にて酸素を注入することによって、チタン膜の表面に酸化チタン(TiO₂)を主とする硬質層を形成した。

【0031】以上のような積層被膜を形成した高弾性コンタクトを用い、ICテスターの導通を繰り返す操作を行なったが、いずれも先の実施例の場合と同様、変色及び付着もなく、良好な結果が得られた。

【0032】以上、本発明の実施例について説明したが、勿論、本発明はこれに限定されることなく、本発明の技術的思想に基づき種々の変形が可能である。

【0033】例えば、実施例ではイオンプレーティング法によって積層被膜を形成したが、スパッタ法によってもよい。

【0034】積層被膜の材質と厚さは、硬度と電気特性を考慮し、目的に応じて選定できるが、厚さについてはコンマ数μm〜10μmの範囲で変えられる。又、ばね特性を調整するため、積層被膜を三重以上の多層膜にしてもよい。

【0035】高弾性コンタクトの材質は実施例ではステンレスばねを用いたが、代わりにステンレス以外の鉄合金、ニッケル合金や銅合金、アルミニウム合金、タングステン、モリブデン、チタンも使用できる。更に、基材の表面に直接積層被膜を形成したが、基材の表面に予め熱処理やコーティング層を施した後に積層被膜を形成してもよい。

【0036】又、積層被膜は密着層と硬質層とからなっているが、被測定物とのなじみを良くする必要がある場合には、更にその上に金や白金の被膜を形成してもよい。この場合は蒸着やスパッタにより膜厚を100〜800Å程度にすればよい。

【0037】又、以上の実施例ではICテスターのコンタクトに高弾性電極を用いたがICソケットのICリードの受け口や電磁リレー等のばね電極にも使用できる。

【0038】

【発明の効果】本発明は従来品と全く異なるコーティング方法を採用しているため、基材に銅合金よりも引張強さ及び弾性限度の高い材料を選ぶことができる。又基材が銅合金であったとしても本発明の被膜は弾性限度を向

6

上させるのに有効な方法なので、ばね特性が改善され、長寿命となる。

【0039】又、被検査物の半田、銀のメッキが本発明の電極には付着しにくく、付着したごみを取ろうとすると酸化防止被膜(金メッキ)まで取れてしまうが、本発明の被膜は、従来品の被膜より基材との密着強度が非常に強く、剥離することは殆どない。又、被膜自体が付着したごみより硬いので、ごみだけを取ることが容易にできる。

【0040】又、基材の材質、厚さや積層被膜の材質、厚さ、層の数等を変えることにより、目的に応じた弾性を有する高弾性電極を適宜選択することができ、更には基材が強化された分だけ、基材を薄くして材料費も節約できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例にかかるICテスターの拡大斜視図である。

【図2】同テスターにおけるコンタクトの一部の拡大断面図である。

【図3】積層被膜を形成する装置の概略模式図である。

【図4】比較実験のための挽み量の測定方法を示す図である。

【図5】コンタクトとICリードの接触動作を示す断面図である。

【図6】A及びBは従来例のコンタクトと、本発明の実施例のコンタクトについて、導通試験を5000回行なった後の接触した面を示す図である。

【図7】従来例の電極と本発明の実施例のコンタクトについて、電気特性を比較したグラフである。

【図8】各種化合物の電気比抵抗を示す図である。

【図9】各種化合物の硬さと融点の関係を示す図である。

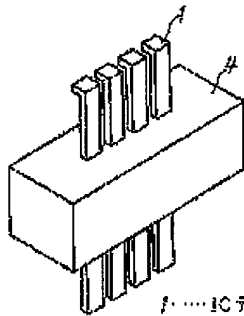
【符号の説明】

- 1 ICテスターのコンタクト
- 2 積層被膜
- 2a 密着層
- 2b 硬質層

(5)

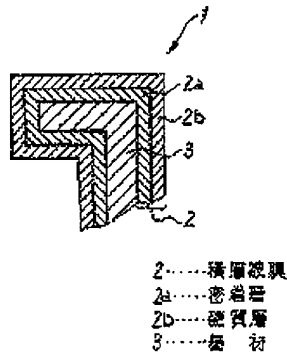
特開平4-354144

【図1】



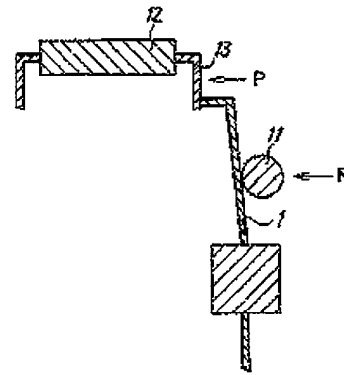
1...ICテストのコネクタ

【図2】

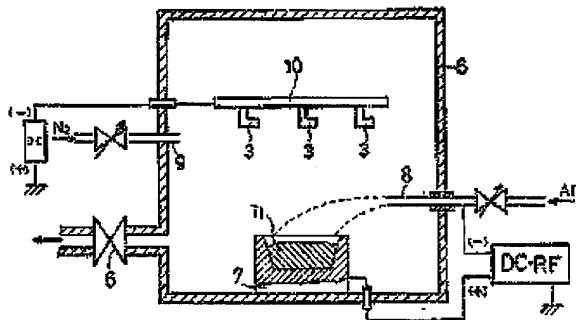


2...積層被膜
2a...窒化珪素
2b...酸化珪素
3...最初面

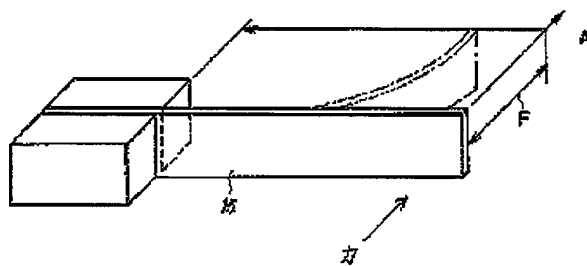
【図3】



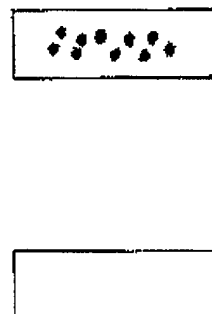
【図3】



【図4】

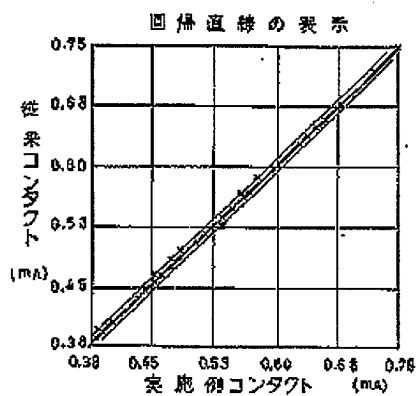


【図5】



特開平 4 - 3 5 4 1 4 . 4

【图 7】

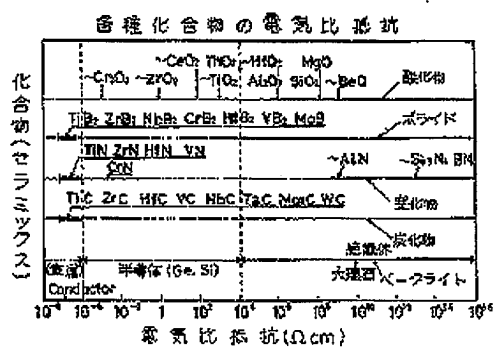


変数名	実験側コンタクト	従来コンタクト
データ数	50	50
最小値	0.380	0.380
最大値	0.750	0.750
平均値	0.525	0.527
標準偏差	0.092	0.092
相関係数	0.999	

$$Y = 0.007 + 0.999 \times X$$

(値 { 153.795 })

【图8】



【圖 9】

